****

***【プレスリリース】***

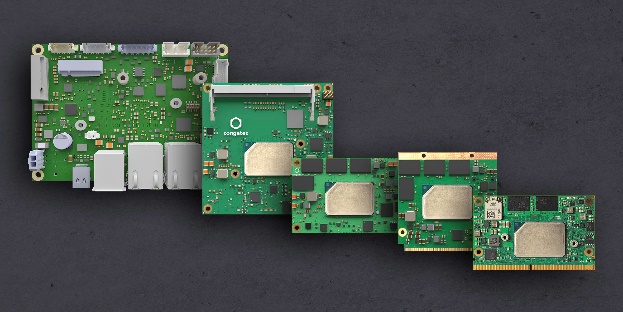
2020年９月24日

報道関係各位

\*本プレスリリースは、[独congatec AGが、2020年9月23日（現地時間）、ドイツで発表したプレスリリース](https://congatec.com/jp/congatec/press-releases/article/whopping-50-more-edge-computing-power/)の抄訳です。

**コンガテック、Intel Atom® プロセッサ x6000Eシリーズの提供開始にあわせ**

**同プロセッサ搭載のフォームファクタ5製品を発表**



**エッジコンピューティングのパワーを50%拡大**

高性能組込みコンピューティング製品のリーディングサプライヤである[congatec（コンガテック）](http://www.congatec.jp/)は、Intel社の低消費電力型プロセッサ最新世代の提供開始に合わせ、同プロセッサを搭載したフォームファクタ5製品の提供を開始したと発表しました。Intel Atom x6000Eシリーズは、SMARC、Qseven、COM Express Compact、COM Express Mini、Pico-ITXシングル・ボード・コンピュータ（SBC）向けにそれぞれプロセッサが用意され、低消費電力の10nmテクノロジーを基盤とするIntel® Celeron®およびPentium® N、Jシリーズプロセッサ（コードネーム：Elkhart Lake）が、エッジに接続される新世代の組込みシステムの活用領域を大きく拡げます。コンガテックの新しいボードやモジュールは、最大で同時に３つのディスプレイ上に4Kp60で表示できるなど、グラフィック性能を2倍に強化したほか、最大4コアの前世代製品と比較して、マルチスレッドのコンピューティング性能を50%以上\*脚注向上させます。さらに、Time Sensitive Networking（TSN）、Intel® Time Coordinated Computing（Intel® TCC）、Real-Time Systems社（RTS）のハイパーバイザのサポート、そしてBIOSの設定可能なECC、

-40°C～+85°Cの拡張温度範囲対応などにより、特にリアルタイム処理が要求される産業市場向け製品開発に多くの優位性をもたらします。

コンガテックのシニア製品ラインマネージャーのユルゲン・ユングバウアー（Jürgen Jungbauer）はこの点について、次のように説明しています。「現在、IoTに接続される産業用アプリケーションに必要とされているのは、オペレーション、接続、ハイパーバイザ技術をいずれも厳密にリアルタイムで処理して組み合わせられることです。その意味で、Intel Atom、Celeron、Pentiumの最新プロセッサを搭載した当社のボードやモジュールは、スマート電力グリッドの分散プロセス制御からスマートロボティクス、ディスクリート製造向けのPLCやCNCまで、産業オートメーションおよび制御市場を大きく変革します。リアルタイム・アプリケーションは、試験や計測、鉄道や道路監視システム、インターネット接続される自律走行車などの交通の分野でも見られるようになっています。24時間365日無停止が要求される各種アプリケーションにおいても、インバンドのエラーコレクションコードによって、専用のECC RAMを用意することなく低価格の標準的なメモリで代用できるようになるため、実装をコスト効率の良いECCに置き換えられることは大きなメリットです」

さらに、最新プロセッサは今日のエッジ接続の組込みシステムに不可欠な多数の機能や性能を備えているため、リアルタイム以外のあらゆるアプリケーションにも最適です。POS、キオスク、デジタルサイネージシステムのほか、配信型ゲームや宝くじ端末など、リモートでM2Mの通信が必要な機器が無数に存在しています。

Intel社の産業用ソリューションディビジョン担当シニアディレクター、ジョナサン・ルース（Jonathan Luse）氏は次のように述べています。「IoTはデバイスからテクノロジー、アプリケーションまであらゆる範囲に及んでいますが、それぞれ独自の需要から特定のタスク専用のコンポーネントやインタフェースの追加や、中には追加のサブプロセッサまでを必要とされるケースも少なくありませんでした。Intel Atom x6000EシリーズとIntel Pentium およびCeleron N、Jの各シリーズのプロセッサは、最新の10nmコンピューティングやグラフィックテクノロジーと多数の機能やI/Oを統合するホストを搭載し、IoTアプリケーション向けのシングルプラットフォームを構築することができます」

こうした目的に応えるため、Intel Atom、CeleronおよびPentiumプロセッサを搭載したコンガテックの新しいボードやモジュールには、包括的な帯域外管理ができる画期的なコプロセッサ実行可能オプションに加え、一貫して真に信頼性の高いアプリケーションを構築するためのあらゆる組込みセキュリティ機能が搭載されています。こうした機能には、検証済みブート、ブート測定値およびIntel® Platform Trust Technology（Intel® PTT）やIntel® Dynamic Application Loader（Intel® DAL）などが含まれます。またコンガテックの新しいボードとモジュールは、開発製品への予知保全をはじめとする機械学習アルゴリズムの実装を加速できるよう、Intel® Distribution of OpenVino™ツールキットやMicrosoft MLをサポートしています。

その他、新製品には拡張帯域幅のために最大4267MT/s、PCIe Gen3、USB 3.1、オンボードUFS2.1（ユニバーサルフラッシュストレージ）をサポートする最大4個の16GBのLPDDRメモリも搭載しています。eMMCと比較して、今回の新しいストレージ技術は帯域幅やデータ処理速度、ストレージ容量を大幅に高めます。これらすべての能力を同一フットプリントで提供し、プライマリブートやストレージ向けに使用することもできます。最新プロセッサの特長の詳細は、コンガテックのウェブページに掲載中の当社ホワイトペーパーをご参照ください。　[www.congatec.com/Intel-Atom-x6000E](http://www.congatec.com/Intel-Atom-x6000E)

新製品のボードおよびモジュールは、Pico-ITX シングル・ボード・コンピュータ（SBC）、SMARC、Qseven、COM Express Compact、COM Express Miniの5種類のフォームファクタで提供され、それぞれ以下のプロセッサ構成が用意されています。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロセッサ** |  | **コア/ スレッド** |  | **クロック[GHz] （高周波モード/ターボ/バースト）** |  | **CPU L2 キャッシュ（MB）** |  | **GFE実行ユニット** |  | **TDP (W)** |
| Intel Atom® X6425E |  | 4 |  | 1.8 / 3.0 |  | 1.5 |  | 32 |  | 12 |
| Intel Atom® X6413E |  | 4 |  | 1.5 /3.0 |  | 1.5 |  | 16 |  | 9 |
| Intel Atom® X6211E |  | 2 |  | 1.2 /3.0 |  | 1.5 |  | 16 |  | 6 |
| Intel Atom® X6425RE |  | 4 |  | 1.9/ - |  | 1.5 |  | 32 |  | 12 |
| Intel Atom® X6414RE |  | 4 |  | 1.5/ - |  | 1.5 |  | 16 |  | 9 |
| Intel Atom® X6212RE |  | 2 |  | 1.2 / - |  | 1.5 |  | 16 |  | 6 |
| Intel® Pentium®J6425 |  | 4 |  | 1.8 / 3.0 |  | 1.5 |  | 32 |  | 10 |
| Intel® Celeron® J6413 |  | 4 |  | 1.8/ 3.0 |  | 1.5 |  | 16 |  | 10 |

SMARC、Qseven、COM Express Compact、Mini Computer-on-Modules、Pico-ITX SBC向け製品の詳細は、コンガテックのウェブページ[www.congatec.com/Intel-Atom-x6000E](https://www.congatec.com/jp/technologies/intel-elkhart-lake/)に掲載されている各製品のデータシートでご確認いただけます。

**##**

\* Intel、OpenVINO、Intel Atom、CeleronおよびPentiumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。

**\*脚注**

出典：Intel社　　 前世代製品としてIntel® Pentium® J4205を使用し、それぞれa) Pre-Si 予測値に基づくSPEC CPU 2006メトリック推定値、b) Pre-Si 予測値に基づく3DMark11推定値に基づく比較

構成：

パフォーマンス数値は2020年9月1日時点の予測に基づく

**プロセッサ：**Intel® Pentium® J6425 PL1=10W TDP, 4C4T最大ターボ3.0GHz

グラフィックス：Intel Graphics Gen 11 gfx

メモリ：16GB LPDDR4-3200

OS：Windows\* 10 Pro

コンパイラバージョン：IC18

**プロセッサ：**Intel® Pentium® J4205 PL1=10W TDP, 4C4T最ターボ大2.6GHz

グラフィックス：Intel Graphics Gen 9 gfx

メモリ：16GB LPDDR4-2400

OS：Windows\* 10 Pro

コンパイラバージョン：IC18

性能に関する数値はPre-Si 予測値であり、変更される場合があります。報告された結果は、追加テストの実施に伴い修正が必要な場合があります。結果は、テストで使用された特定のプラットフォーム構成およびワークロードに依存しており、特定のユーザコンポーネント、コンピュータシステム、ワークロードには適用されない場合があります。結果は必ずしも他のベンチマークを代表するものではありません。

**コンガテックについて**コンガテックは、産業用組込みコンピューティングに特化したテクノロジーと製品で急速な成長を遂げている企業です。高性能コンピュータモジュールは、産業オートメーション、医療、輸送、通信、その他多くの業種のさまざまな用途やデバイスに対応しています。スタートアップからグローバル優良企業まで、優れた顧客基盤をもつコンピュータ・オン・モジュール分野のグローバルマーケットリーダです。2004年設立、ドイツのデッゲンドルフに本社を置き、2019年の売上高は1億2,600万ドルです。詳しくは、[当社ウェブサイト](https://www.congatec.com/jp/)、または[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449)、[Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG)、[YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE)をご覧ください。

**■本製品に関するお問合せ先**

コンガテック ジャパン株式会社　担当：奥村

TEL: 03-6435-9250 Email: sales-jp@congatec.com

**■本リリースに関する報道関係者様からのお問合せ先**

コンガテック ジャパン株式会社　（同上） または

（広報代理）　プラップジャパン　高橋、谷本

Email: congatec@prap.co.jp